

## Halbleiterhersteller müssen die Leistung ihrer Produkte verbessern - LPKF hat die Lösung

Ansprechpartner:  
Bettina Schäfer  
bettina.schaefer@lpkf.com  
Tel. +49 5131 7095-1382  
Fax +49 5131 7095-90

LPKF  
Laser & Electronics SE  
Osteriede 7  
30827 Garbsen  
www.lpkf.de

Vorstand:  
Dr. Klaus Fiedler (CEO)  
Christian Witt (CFO)

Aktie:  
Prime Standard  
ISIN 0006450000

*Garbsen, 13. Mai 2024* - Die Miniaturisierung von Mikrochips stößt mehr und mehr an ihre physikalischen Grenzen. Halbleiterhersteller müssen neue Wege finden, um die Leistung ihrer Produkte weiter zu verbessern und den ständig steigenden Anforderungen von Technologien wie der generativen KI gerecht zu werden. Dabei rückt das direkte Umfeld des Chips mehr in den Fokus. Mehrere namhafte Akteure der Halbleiterindustrie haben nun einen Paradigmenwechsel angekündigt: Glas als Trägermaterial für Advanced Packaging. Das hat fundamentale Veränderungen in der Branche eingeleitet. LPKFs LIDE-Technologie (Laser Induced Deep Etching) ist ein ausgereifter Prozess, der diese Transformation vom Ramp-up bis zur Großserienfertigung ermöglicht.

### Advanced Packaging mit Glassubstraten

Das Advanced Packaging ist heute eine strategisch wichtige Disziplin in der Chip-Herstellung. Es ermöglicht den Chip-Architekten, hoch integrierte Schaltkreise enger miteinander zu verbinden. Mit Glassubstraten anstelle von organischen oder Silizium-Substraten können noch mehr Chips in einem System integriert werden. Die Systeme werden dadurch schneller, nehmen weniger Platz ein und verbrauchen weniger Strom.

"Der Gedanke, Glas als Substratmaterial einzusetzen, ist nicht neu, aber bisher war es sehr schwierig, es in einer Qualität zu verarbeiten, die den hohen Anforderungen der Branche gerecht wird", sagt Dr. Roman Ostholt, Geschäftsführer Electronics bei LPKF und Hauptentwickler von LIDE. „Mit LIDE können Glassubstrate von 100µm bis zu 1,1mm schnell, präzise und ohne Beschädigungen bearbeitet werden.“

### Hohe Prozessreife der LIDE-Technologie

"Unsere Technologie hat einen professionellen Reifegrad erreicht und kann die hohen Anforderungen der Halbleiterindustrie erfüllen", sagt Dr. Klaus Fiedler, Vorstandsvorsitzender von LPKF. "Um der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden, haben wir unsere Produktionskapazitäten für LIDE an unserem Hauptsitz in Garbsen erweitert."

Der hohe Reifegrad des Verfahrens und der Nachweis der Leistungsfähigkeit haben bereits verschiedene führende Halbleiterhersteller überzeugt, mit LPKFs

LIDE-Technologie zu arbeiten. "Unsere Kunden schätzen die Präzision und Flexibilität, die wir ihnen bieten können, und sind vor allem von den neuen Designmöglichkeiten, die LIDE ihnen eröffnet, beeindruckt", so Ostholt.

Branchenexperten gehen davon aus, dass sich der Wandel in der Halbleiterindustrie hin zu einer hochvolumigen Fertigung von Glassubstraten in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts vollziehen wird. LPKF ist jetzt bereit, diesen Wandel mit seinem herausragenden Know-How und seinen Maschinenlösungen voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie hier: <https://lide.lpkf.com/de>

#### **Über LPKF**

Die LPKF Laser & Electronics SE ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).